مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، (JSIAU) سال ۲۱ ، شماره ۷۹ ، بهار ۱۳۹۰

> بررسی اثر کاشت هیدروژن در نمونه بلوری کاربید سیلیسیم (SiC) قبل و بعد از اکسیداسیون گرمایی در محیط اکسیژن

برهان ارغوانی نیا^{*} گروه فیزیک، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران محمدرضا حنطهزاده گروه فیزیک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران داود آقاعلی گل، علی باقی زاده گروه فیزیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

تاریخ پذیرش: ۸۹/۳/۱۹

تاریخ دریافت: ۸۹/۲/۸

چکیدہ

۱

مقدمه: امروزه SiC در صنعت نیمه هادی ها کاربرد و اهمیت فراوانی پیدا کرده است، به ویژه ایس ماده در نمودار تک بلوری آن می تواند در ساخت قطعات الکترونیکی دمای بالا، توان بالا و فرکانس بالا مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این نیمه هادی کاربردهای گوناگونی در دیودهای لیزری، فوتودیودها و سنسورهای مختلف دارد. کاربید سیلیسیم (Silicon Carbide) یک نیمه هادی غیر مستقیم با گاف نواری پهن می باشد. ایس نیمه هادی از کاربید همچنین این نیمه هادی کاربردهای گوناگونی در دیودهای لیزری، فوتودیودها و سنسورهای مختلف دارد. کاربید سیلیسیم (Silicon Carbide) یک نیمه هادی غیر مستقیم با گاف نواری پهن می باشد. ایس نیمه هادی از کاربید هاد فیزیکی بسیار سخت است و خواص الکتریکی و اپتیکی آن متناسب با نوع ساختاری که دارد با یکدیگر کاملا لحاظ فیزیکی بسیار سخت است و خواص الکتریکی و اپتیکی آن متناسب با نوع ساختاری که دارد با یکدیگر کاملا معاوت است. در تمام ساختارهای بلوری Sic درصد اتم کربن با ٥٠ درصد اتم C با سندی و کووالانسی با یکدیگر پیوند دارند. اما با توجه به اینکه نحوه آرایش اتم های Si و C در داخل شبکه Sic به چه متفاوت است. در تمام ساختارهای بلوری Sic درصد اتم کربن با ٥٠ درصد اتم C با سندیگر کاملا می بایدری کار کار کار کار کار در ماند. ما با نوع ساختاری که دارد. اما با توجه به اینکه نحوه آرایش اتم های Si و C در داخل شبکه Sic به مینکی کووالانسی با یکدیگر پیوند دارند. اما با توجه به اینکه نحوه آرایش اتم های Si و C در داخل شبکه Sic به منود که هر یک از آنها دارای خواص فیزیکی مورداری باشد، ساختارهای متفاوتی (Politypes) از Sic ایجاد می شود که هر یک از آنها دارای خواص فیزیکی موداری باشد، ساختارهای متفاوتی (Politypes) از Sic مانو که در صنعت نیمه هادی کاربرد فراوان دارد عبارتند از نموداری باشد، ساختارهای مده می Sic که در صنعت نیمه هادی کاربرد فراوان دارد عبارتند از نی مادوری با Sic مانو در در در اوان دارد عبارتند از ما معنور به خود است. اما چند ساختار مه م Sic که در صنعت نیمه هادی کاربرد فراوان دارد عبارتند از یر منوح به خوان زیر معود است. اما هرد ساختار مه می Sic که در صنعت نیمه هادی کاربرد فراوان دارد عبارتند از در منحت نیمه هادی کاربرد فراوان دارد عبارت دانو در در موامان زیر منحو به مواد است. اما و Sic که در صنعت نیمه هادی کاربرد فراوان دارد مر در دار در

*عهده دار مكاتبات: ايميل b.arghavani@gmail.com

هدف:در این مقاله اثر کاشت یون هیدروژن با دز²atom/cm¹ ۱۰^۱۱ و انرژی ۱۰keV در ساختار سطحی بلور 6H-SiC قبل و بعد از اکسیداسیون گرمایی در محیط اکسیژن، مورد بررسی قرار گرفته است.

روش بررسی: سطح بلور SiC در دو ناحیه کاشت شده و بدون کاشت با کمک میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) بررسی و مقایسه شده است. همچنین کیفیت ساختار بلوری و اثر کاشت هیدروژن در ساختار بلور با استفاده از آنالیز پس پداکندگی رادرفورد (RBS-Channeling) و نحوه توزیع هیدروژن در عمق نمونه با تکنیک ERD مطالعه شده است. علاوه بر این پیوند بین اتم های کاربید سیلیسیم(SiC)در دو ناحیه با استفاده از تکنیک تبدیل فوریه نور مادون قرمز(FTIR) بررسی شده است.

نتایج: نتایج حاصل از آنالیز AFM افزایش نایکنواختی سطح در ناحیه کاشت شده را نسبت به ناحیه بدون کاشت نشان می دهند، اما نشانه ای از تاثیر کاشت بر روی نانوخراش های ایجاد شده بعد از فرآیند زدایش دیده نمی شود. همچنین، ایجاد آسیب شبکه ای اندکی بر اثر برخورد هیدروژن با اتم های سیلیسیم و کربن در نتایج آنالیز کانال زنی دیده می شود. علاوه بر این، نتایج FTIR بدست آمده از ناحیه کاشت شده با هیدروژن اختلاف قابل توجهی را نسبت به ناحیه کاشت نشده با هیدروژن بعد از اکسید در محیط اکسیژن نشان می دهد.

نتیجه گیری: با استفاده از ERD توزیع اتم های هیدروژن در SiC با دقت خوبی تعیین شد و مقایسه آن با نتایج شبیه سازی نشان داد که ماکزیمم توزیع اتم های هیدروژن در عمق حدود ۲۰۰ ناومتر هست. این مقایسه همخوانی خوب بین نتایج تجربی و شبیه سازی را نشان می دهد. نتایج آنالیز RBS-Channeling اختلاف بین لایه اکسید رشد داده شده در ناحیه کاشت شده و بدون کاشت را نشان داد. علاوه بر این نتایج حاصل از FTIR نشان داد اگر چه تفاوت چشمگیری بین طیفهای بدست آمده از دو ناحیه کاشت شده و کاشت نشده قبل از اکسیداسیون وجود ندارد ، اما شدت پیک عبوری مربوط به پیوند Si با O دو ناحیه کاشت شده و کاشت نشده بعد از اکسیداسیون در این ناحیه تفاوت چشمگیری با هم دارند و پیک مربوط به کربن و هیدروژن در ناحیه کاشت شده به وضوح آشکار می شود.

واژه های کلیدی: کاشت یونی، SiC، اکسیداسیون گرمایی، آسیب بلوری

مقدمه

۲

کاربید سیلیسیم (Silicon Carbide) یک نیمه هادی غیر مستقیم با گاف نواری پهن می باشد. ایس نیمه هادی از لحاظ فیزیکی بسیار سخت است و خواص الکتریکی و اپتیکی آن متناسب با نوع ساختاری که دارد با یکدیگر کاملا متفاوت است. در تمام ساختارهای بلوری Sic ، ۵۰ درصد اتم کربن با ۵۰ درصد اتم C با استفاده از پیوند کووالانسی با یکدیگر پیوند دارند. اما با توجه به اینکه نحوه آرایش اتم های Sic و C در داخل شبکه SiC به پیوند کووالانسی با یکدیگر پیوند دارند. اما با توجه به اینکه نحوه آرایش اتم های Sic و C در داخل شبکه Sic به پیوند کووالانسی با یکدیگر پیوند دارند. اما با توجه به اینکه نحوه آرایش اتم های Sic و C در داخل شبکه Sic به sic به در می یوند کوالانسی با یکدیگر یوند دارند. اما با توجه به اینکه نحوه آرایش اتم های Sic و C در داخل شبکه Sic به پیوند کووالانسی با یکدیگر یوند دارند. اما با توجه به اینکه نحوه آرایش اتم های Sic و C در داخل شبکه Sic به پیوند کووالانسی با یکدیگر یوند دارند. اما با توجه به اینکه نحوه آرایش اتم های Sic و C در داخل شبکه Sic به پیوند کووالانسی با یکدیگر یوند دارند. اما با توجه به اینکه نحوه آرایش اتم های Sic و C در داخل شبکه Sic به پیوند کووالانسی با یکدیگر یوند دارند. اما با توجه به اینکه نحوه آرایش اتم های Sic و C در داخل شبکه Sic به sic و C در می شود که هر یک از آنها دارای خواص چه نموداری باشد، ساختارهای متفاوتی (Politypes) از Sic ایجاد می شود که هر یک از آنها دارای خواس فیزیکی منحصر به خود است. اما چند ساختار مهم Sic که در صنعت نیمه هادی کاربرد فراوان دارد عبارتند از: فیزیکی منحصر به خود است. اما چند ساختار مهم Sic که در صنعت نیمه هادی کاربرد فراوان دارد عبارتند از:

مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، (JSIAU)، سال ۲۱، شماره ۷۹، بهار ۹۰

لایه در صنعت نیمه هادی ها مورد استفاده قـرار مـی گیـرد. در ایـن پـژوهش از تـک کریـستال SiC بـا سـاختار 6H- SiC استفاده شده است.

امروزه SiC در صنعت نیمه هادی ها کاربرد و اهمیت فراوانی پیدا کرده است،به ویژه این ماده در نمودار تک بلوری آن می تواند در ساخت قطعات الکترونیکی دمای بالا، توان بالا و فرکانس بالا مورد استفاده قرار گیرد.^(۲) همچنین این نیمه هادی کاربردهای گوناگونی در دیودهای لیزری، فوتودیودها و سنسورهای مختلف دارد.^(۳-۲)

یکی از روش های متداول برای تغییر خواص تک بلورهایی مانند SiC جهت استفاده در تکنولوژی نیمه هادی ها، کاشت یون های مختلف مانند سیلیسیم، آلومینیوم، هیدروژن،فسفر و ... در این بلور است.^(۲-۵) همچنین کاشت هیدروژن جهت برداشتن لایه نازکی از سطح بلور کاربید سیلسیم به عنوان راهکاری جهت ایجاد فیلم های کاشت هیدروژن جهت برداشتن لایه نازکی از سطح بلور کاربید سیلسیم به عنوان راهکاری جهت ایجاد فیلم های کاربیدسیلیسیم روی عایق (SiCOI) که در ساخت قطعات الکترونیکی با گاف نواری پهن کاربرد دارند موارد استفاده فراوانی دارد.^(۵) علاوه بر توجه به ایجاد لایه های نازک از کاربیدسیلیسیم، تاثیر کاشت یون بر اکسید این نیمه هدی نیز مورد توجه فراوان قرارگرفته است.

هدف کلی در این مقاله بررسی کاشت هیدروژن در ساختار بلوری کاربیدسیلیسیم و تاثیر ان بر اکسیداسیون گرمایی آن است. در ابتدا تاثیر کاشت هیدروژن در ساختار بلوری این نیمه هادی با استفاده از تکنیک های RBS-Channeling و RBS مورد مطالعه قرار می گیرد. بعد از اکسیداسیون، تاثیر ناخالصی هیدروژن بر افزایش سرعت رشد اکسید نیز با روش RBS-Channeling مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اثر کاشت هیدروژن بر مورفولوژی سطح نیمه هادی قبل از اکسیداسیون گرمایی در دو ناحیه کاشت شده و بدون کاشت با یون های هیدروژن با استفاده از تکنیک AFM مورد بررسی قرار گرفته است. برای بدست آوردن اطلاعاتی در مورد نحوه پیوندهای ایجاد شده بین اتم های کربن، سیلیسیم و هیدروژن بعد از کاشت یونی در Sic قبل و بعد از اکسیداسیون، از تکنیک RTR استفاده شده است.

مواد و روشها

روش انجام آزمایش

در این پژوهش از تک بلور 6H-SiC با کیفیت بلوری خوب و صیقل شده در جهت بلوری (۰۰۰۱) استفاده شده است. کاشت هیدروژن با انرژی ۱۵ کیلو الکترون ولت و دز atom/cm² ۲۰۱۰ در آزمایـشگاه Oak Ridge کشور آمریکا انجام شده است. قبل از آنالیز نمونه را تحت هیچگونه فرآیند حرارتی قرار نمی دهیم تا بتوان تاثیر احتمالی کاشت هیدروژن را در سطح و شبکه بلوری مشاهده کرد.

بررسی سطح با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی در آزمایشگاه بخش لیزر نیمه هادی پژوهشگاه علوم و تکنولوژی هسته ای صورت پذیرفته است. جهت انجام اندازه گیری های میکروسکوپ نیروی اتمی از دستگاه مدل Dual Scope 95-50 در پژوهشکده لیزر پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای استفاده شده است. برای انتخاب بهترین ناحیه جهت آنالیز AFM، ابتدا ناحیه ای به ابعاد 50µm×50µm آنالیز شد و سپس ناحیه آنالیز به RBS/C کاهش داده شد. آنالیز RBS/C با یون های فرودی هلیوم با انرژی MeV در زاویه فرود عمود بر سطح نمونه و زاویه برگشتی ۱٦٥ درجه در آزمایشگاه واندوگراف پژوهشگاه علوم و تکنولوژی هسته ای انجام گرفته است. نمونه بر روی گونیومتری با سه درجه آزادی زاویه ای قرار داده شد. ذرات برگشتی از نمونه نیز توسط یک آشکارساز سد سطحی آشکار شده است. به منظور بررسی دقیق تر نمونه در دو ناحیه کاشت شده و بدون کاشت، از تکنیک تبدیل فوریه نور مادون قرمز (FTIR) استفاده شد. آنالیز نمونه ها در ناحیه طول موج ۹۰۰ تا 1500nm و در دانشکده شیمی دانشگاه تهران انجام شده است.

به منظور انجام اکسیداسیون گرمایی، از کوره حرارتی آزمایشگاهی استفاده شد که حداکثر دمای آن °۲۰۰۰ و با دقت ۱± درجه قابل کنترل است. اکسیداسیون در محیط اکسیژن با خلوص ۹۹/۹۹ درصد انجام پذیرفت. اکسیداسیون گرمایی SiC نمونه در محیط اکسیژن خالص در دمای C°۱۱۰۰ و به مدت ۹۰ دقیقه انجام شده است. محیط اکسیداسیون که در داخل محفظه استوانه ای از جنس کوارتز قرار داشت به مدت چند دقیقه قبل از قرار دادن نمونه تحت عبور گاز اکسیژن قرار گرفت تا محیط از اکسیژن خالص پر گردد در حالیکه دو سر لوله کوارتز تا حد زیادی مسدود شده بود.

نتايج و بحث

نمودار ۱ طیف RBS بدست آمده از نمونه را در دو حالت کاتوره ای و کانالی نشان می دهد. آنالیز RBS/C راهی مناسب جهت بررسی کیفیت بلور مورد مطالعه است. ^(۲-۱۱, ٥-۹) در این روش آنالیز سعی می شود تا با هدایت باریکه ای از ذرات فرودی در راستای بلوری شبکه مورد مطالعه و مقایسه تعداد ذرات برگشتی در دو حالت کانالی و کاتوره ای، کیفیت بلور مورد مطالعه و آسیب های احتمالی موجود در شبکه را مورد بررسی قرار دهیم. در نمودار ۱ مقایسه تعداد ذرات آلفای برگشتی دو طیف کانالی و کاتوره ای نشان دهنده افت بسیار زیاد ذرات شمارش شده در حالت کانالی نسبت به حالت کاتوره ای است. بنابراین این آنالیز نشان می دهد که بلور مورد مطالعه از کیفیت خوبی برخوردار است. ^(۱۱،۲) محاسبات نشان می دهد، نسبت تعداد ذرات برگشتی در دو طیف کانالی و کاتوره ای در ناحیه ای درست پایین ناحیه آسیب سطحی برابر ۲۶/۰ است. (در صورتی که شبکه بلوری مطالعه از کیفیت خوبی برخوردار است. ^(۱۱،۲)

www.SID.ir



نمودار ۱ – طیف های کانالی و کاتوره ای از بلور SiC. پیک های ناشی از آسیب ایجاد شده بر اثر کاشت هیدروژن در طیف کانالی مشخص است.

شبیه سازی با نرم افزار TRIM ^(۱۱) ماکزیمم غلظت یون های کاشت شده با انرژی ۱۵ کیلوالکترون ولت هیـدروژن را در عمق حدود ۱۳۰۰ آنگستروم به دست می دهد. نمودار ۲ نتایج این شبیه سـازی را در تخمین آسـیب بلـوری ایجاد شده در این شبکه نشان می دهد. البته باید توجه کرد که این نرم افزار هدف را به صورت تک بلـور در نظـر نمی گیرد. در نمودار ۲ ، تعداد جاخالی های ایجاد شده بر اثر جابجایی اتم های سیلیسیم و کربن با تعداد جابجایی های اتم های این عناصر از مکان شبکه ای آنها برابر است. مقایسه تعداد کل جابجایی ها با چگالی میانگین در نظـر گرفته شده توسط نرم افزار برای بلور Sic که ²⁰ atoms/cm³ است، نشان می دهد که آسیب ایجاد شده به گونه ای نیست تا شبکه بلوری را به حالتآمورف تبدیل کند. به دلیل اختلاف جرم اتـم هـای کـربن و سیلیسیم، می شود. همانظور که از محاسبات با نرم افزار الاک انتظار داشتیم میزان آسیب ایجاد شده می شود. همانظور که از محاسبات با نرم افزار الاک انتظار داشتیم میزان آسیب ایجاد شده در شبکه بلـوری زیاد نیست. پیک وسط در نمودار ۱ مربوط به اکسیژن در سطح نمونه است (انرژی ۲۵۷/۱۹۷۶ در طیف کانالی نمودار ۱ دیده نیست. پیک وسط در نمودار ۱ مربوط به اکسیژن در سطح نمونه است (انرژی ۲۵/۱۹ لا در طیف) که بـه دلیـل بعدی با محلول رقیق HT تمیز می گردد.



نمودار ۲ – نتایج شبیه سازی انجام شده با نرم افزار TRIM در بررسی آسیب بلوری ایجاد شده در SiC بعد از کاشت یون های هیدروژن با انرژی 15keV.

به منظور بررسی وجود هیدروژن و تعیین نحوه توزیع هیدروژن کاشت شده در بلور SiC، در این پژوهش از تکنیک ویژه ای استفاده شده است که به آنالیز پس زنی الاستیک (Elastic Recoil Detection) معروف است.^(۱۱) در ایس روش آنالیز از یونی سنگین تر از اتم های هیدروژن برای آنالیز نمونه حاوی هیدروژن استفاده می شود. به دلیل جرم سنگین تر یون های فرودی، که در این آزمایش یون های هلیوم می باشند، اتم های هیدروژن موجود در نمونه از شری بر اثر عمق های محمود می باشد، اتم های هیدروژن موجود در نمونه داوی میدروژن استفاده می شود. به دلیل جرم سنگین تر از اتم های میدروژن برای آنالیز نمونه حاوی هیدروژن استفاده می شود. به دلیل جرم سنگین تر یون های فرودی، که در این آزمایش یون های هلیوم می باشند، اتم های هیدروژن موجود در نمونه از بر اثر عمق های مختلف نمونه کنده می شوند و توسط آشکار ساز سد سطحی ثبت می گردند. ذرات آلفای برگشتی بر اثر برخورد با اتم های سیلیسیم و کربن توسط ورقه نازکی از کپتون(Solor2015) به ضخامت ۷٫۵ میکرومتر که در جلوی آشکارساز قرار گرفته است می گردند.

نمودار ۳ نتیجه حاصل از آزمایش ERD و شبیه سازی طیف به دست آمده با دو نرم افزار^(۱۱) SIMTRA6.05 و SIMTarget 1.3 را نشان می دهد. با توجه به نتایج شبیه سازی، پارامترهای متناسب با توزیع اتم های هیدروژن در نمونه، عمق SIMTarget 10¹⁵ atoms/cm² برای ماکزیمم غلظت و مساحت زیر پیک که با دز اتم هیدروژن در نمونه برابر است، *atom/cm² (*۰۰,۲۲۲ به دست می آیند. با تبدیل واحد عمق به نانومتر (ضریب ۰,۲۲۲)، اختلاف son بین نتایج تجربی و نتایج شبیه سازی TRIM98 دیده می شود که این اختلاف از خطاهای آزمایش تجربی و عدم توانایی برنامه TRIM در شبیه سازی نمونه های تک بلور ناشی می شود.



نمودار ۳- طیف ERD از نمونه SiC کاشت شده با هیدروژن با انرژی I5keV که با یون های آلفای 2.3MeV و در زاویه فرودی ۲۰ درجه بدست آمده است.

برای بررسی سطح بلور SiC در دو ناحیه کاشت شده و بدون کاشت از تکنیک AFM استفاده می شود. نمودار ٤ تصویر AFM از دو ناحیه کاشت شده با هیدروژن و بدون کاشت را نشان می دهد. در این تصاویر به وضوح می توان شیارهایی مشاهده نمود که در تصویر دو بعدی از سطح به صورت خطوط متقاطع دیده می شوند. این شیارها بر اثر فرآیند صیقل(polish) بلور SiC ایجاد می شوند. این شیارها بر خواص ساختار به دست آمده بعد از فراهم نمودن لایه دیگری بر روی زیرماده می توانند تاثیرگذار باشند و مورفولوژی فصل مشترک زیرلایه SiC و لایه رویی آن را دچار تغییر نمایند. آزمایش ها نشان داده است که بازپخت گرمایی در دماهای مختلف یا زدایـش در محیط های بخصوص می تواند در رفع این خراش ها موثر باشد. ^(۱۱)



نمودار ٤ - تصوير AFM از ناحيه كاشت نشده (a) و كاشت شده با هيدروژن(b).

نمودار ۵ نحوه تغییرات ارتفاع یک مقطع از نمودار های ٤ را نشان می دهد . دره های واضح در این نمودار مربوط به خراش های موجود در سطح بلور است. پهنای این خراش ها در حدود ۱۰۰ نانومتر و عمق آنها بین ۳ تا ٤ نانومتر به دست می آید.



نمودار ٥ - پروفایل تغییر ارتفاع سطح بلور از a.ناحیه بدون کاشت و b. ناحیه کاشت شده با هیدروژن.

با مقایسه نتایج دیگر بدست آمده از قسمت های مختلف دو ناحیه بدون کاشت و کاشت شده، مـشخص مـی شـود کاشت هیدروژن تاثیری در برطرف کردن یا افزایش این خراش ندارد. این نتیجه را می توان به جرم کم هیـدروژن و دز پایین کاشت در این آزمایش مربوط دانست. همچنین نواحی سفید رنگ مـشاهده شـده در نمـودار 4 بـه تـشکیل حباب های سطحی مربوط می شود که در اثر کاشت هیدروژن در زیر لایه ایجاد می شود و به وضوح اندازه آنها در ناحیه کاشت شده با هیدروژن بزرگتر است.

نمودار ٦ تصویر سه بعدی از سطح دو ناحیه کاشت شده و بدون کاشت را نشان می دهد که در ابعاد 5µm×5µm اسکن شده است. در تصاویر می توان خراش ها را به صورت دره هایی مشاهده نمود.



نمودار٦ - تصویر سه بعدی از دو ناحیه کاشت شده و بدون کاشت

جدول ۱ نتایج بدست آمده از آنالیز آماری روی تصاویر AFM را برای دو ناحیه نشان می دهد. در این آنالیز علاوه بر بررسی کل هر تصویر، دو ناحیه با ابعاد μm×1μm که شامل خراش ها و بدون خراش ها است در هر تصویر بررسی شده است. پارامتر Sq که اندازه ای از پراکندگی داده ها از مقدار میانگین ارتفاع در ناحیه مورد بررسی است برای ناحیه کاشت شده ۲ تا برای ناحیه که ندازه ای از پراکندگی داده ها از مقدار میانگین ارتفاع در ناحیه مورد بررسی است برای ناحیه با ابعاد ۳μ۳×۳μ۳ که شامل خراش ها و بدون خراش ها است در هر تصویر بررسی شده است. پارامتر Sq که اندازه ای از پراکندگی داده ها از مقدار میانگین ارتفاع در ناحیه مورد بررسی است برای ناحیه کاشت شده ۲ تا مای ۳ برای ناحیه بدون کاشت است، به طوری که نسبت این پارامتر در ناحیه کاشت شده ۲ تا ۳ برای ناحیه بدون کاشت است. علت این را می توان در برخورد یون های هیدروژن فرودی با اتم های سطح بلور و تاثیر آنها بر سطح بلور جستجو کرد.همچنین پارامتر Sy ارتفاع میانگین در ناحیه مورد بررسی را ناخان می دهد. مورد بردسی را ناحیه مورد یون مای مورد یون مای هیدروژن فرودی با تم های می دهد. می مورد برسی را ناخی می دود با تم می می مورد برد می توان در برخورد یون های هیدروژن فرودی با تم های می دهد. مقایسه نتایج دو ناحیه کاشت شده و کاشت نشده نتیجه گیری به دست آمده از مقادیر Sq را تایید می کند.

	ناحيه ب <i>دو</i> ن كاشت		ناحيه كاشت شده	
	بخش با خراش	بخش بدون خراش	بخش با خراش	بخش بدون خراش
Sy	9.2nm	5.75nm	13.2nm	15.1nm
Sq	1.67nm	829pm	1.77nm	1.94nm

جدول ۱- نتایج بدست آمده از آنالیز آماری تصاویر AFM .

نتایج بدست آمده از آنالیز RBS نمونه بعد از اکسیداسیون گرمایی SiC در محیط اکسیژن خالص در دمای C°۰۱۱۰ و به مدت ۹۰ دقیقه، در نمودار ۷ نشان داده شده است. همان طور که در این شکل مشاهده می شود، ضخامت اکسید رشد داده شده کم می باشد در حالیکه اکسیداسیون گرمایی SiC در محیط بخار آب سرعت بیشتری دارد. ^(۱۲ - ۱۰) چنین تفاوتی نیز در مورد اکسیداسیون گرمایی سیلیسیم مشاهده می شود اما در مورد سیلیسیم، سرعت رشد اکسید گرمایی بسیار بیشتر از مورد مشابه برای SiC است .



نمودار ۷ – طیف های RBS از نمونه بعد از اکسیداسیون گرمایی در دمای ۱۰۵۰C و زمان ۹۰ دقیقه به دست آمده با یون های آلفا و در دم راستای کانالی و کاتوره ای.

آنالیز RBS تفاوت اندکی را برای ضخامت لایه اکسید در ناحیه کاشت شده و کاشت نشده نشان می دهد به طوریکه پیک اکسیژن در طیف های RBS در حالت کاتوره ای برای ناحیه کاشت شده (دایره های تو پر) مقدار بیشتری را نسبت به مقدار اکسیژن در طیف ناحیه کاشت نشده (دایره های خالی) نشان می دهد. به دلیل حساسیت پایین آشکارساز، ضخامت لایه اکسید در لبه سیلیسیم به صورت پله ای واضح دیده نمی شود. در حالیکه گزارش های قبلی^(۸-۷.۱) نشان می دهد استفاده از یون های سنگین ترمانند آرگون با آسیب بلوری زیاد در شبکه باعث افزایش سرعت رشد اکسید در SiC می شود. در حقیقت، برخورد یون های فرودی با اتم های شبکه SiC باعث می شود که موجب اختلال در پتانسیل منظم شبکه ای بلور در این نواحی می شود. اما با توجه به محاسبات انجام شده در نمودار ۲ و نتایج تجربی به دست آمده از آنالیز RBS، مشاهده می شود. اما با توجه به محاسبات انجام شده در نمودار ۲ و نتایج تجربی به دست آمده از آنالیز RBS، مشاهده می شود حایجایی اتم های شبکه SiC در اثر

برخورد یون های هیدروژن با آن و در نتیجه آسیب بلوری ایجاد شده در شبکه کم است. بنابراین اثر کاشت یون های هیدروژن بر شبکه بلوری SiC و تاثیر آن بر سرعت رشد اکسید نمی تواند با تاثیر کاشت یون های سنگین تر مقاسسه گردد. همچنین برای بررسی پیوند بین اتم های SiC و هیدروژن در دو ناحیه کاشت شده و کاشت نشده از تکنیک FTIR استفاده شده است. FTIR که مخفف " تبدیل فوریه نور مادون قرمز" است، روشی برتر در اسپکتروسکوپی مادون قرمز است. در این روش، تابش IR از یک نمونه عبور می کند. مقداری از این تابش مادون قرمز توسط نمونه جذب می شود و مقداری نیز از آن عبور می کند. طیف به دست آمده از این تکنیک جذب یا گذار را نشان می دهد و یک اثر انگشت مولکولی از نمونه فراهم می کند.

در نمودار ۸ طیف حاصل از آنالیز FTIR بدست آمده از نمونه SiC قبل از اکسیداسیون گرمایی در محیط اکسیژن، در دو ناحیه کاشت شده با هیدروژن و بدون کاشت هیدروژن نشان داده شده است . پیکی که در عدد موج حدود ¹-mo ۲۰۰۰دیده می شود، مربوط به پیوند Si با کاست. برای اینکه تغیرات ایجاد شده در دو ناحیه مشاهده شود در این نمودار بازه بین عدد موج ¹⁻mo ۲۰۰۰تا ¹⁻ ۲۰۰۰ با بزرگنمایی بیشتری در نزدیک پیک عبوری به صورت ضمیمه نشان داده شده است. همان طور که در نمودار دیده می شود طیف مربوط به ناحیه دارای هیدروژن، اند کی به سمت چپ جابجا شده است که این تغییر می تواند به خاطر وجود اتم های هیدروژن باشد. ولی چون این تغیرات کم است پیکی مربوط به پیوند کربن با هیدروژن در نمودار ۸ مشاهده نمی شود.



نمودار۸- تصاویر FTIR از نمونه SiC قبل از بازپخت در محیط اکسیژن در دو ناحیه کاشت شده و بدون کاشت با هیدروژن

در نمودار ۹ طیف حاصل از آنالیز FTIR بدست آمده از نمونه SiC بعد از اکسیداسیون گرمایی در محیط اکسیژن، در دو ناحیه کاشت شده با هیدروژ ن و بدون کاشت هیدروژن نشان داده شده است . همان طور که مشاهده می شود طیف FTIR بدست آمده بعد از اکسیداسیون در محیط اکسیژن در دو ناحیه کاشت شده و کاشت نشده با هیدروژن اختلاف زیادی با یکدیگر دارند. در طیف بدست آمده از ناحیه کاشت نشده (SiC خالص) تنها دو پیک عبوری مربوط به پیوند Si با C در عدد موج حدود ¹⁻ ۱۰۰۰ و پیک عبوری مربوط به پیوند Si با C در عدد موج حدود ¹ ۲۰۰۰ دیده می شود. اما در طیف بدست آمده از ناحیه کاشت شده با هیـدروژن پیـک عبـوری متفاوتی دیده می شود.^(۱۹) در این ناحیه دو پیک عبوری مربوط به پیوند Si با C در عدد موج حـدود ^{۱-۱} ۲۰۰۰ و پیک عبوری مربوط به پیوند Si با C در عدد موج حـدود ^۱ یک عبوری و پیک عبوری مربوط به پیوند Si با C در عدد موج حـدود این ناحیه می شود با پیک عبوری مربوط به پیوند Si با C در عدد موج حـدود این ناحیه می شود با پیک عبوری مربوط به پیوند Si با C در عدد موج حـدود در این ناحیه کافت شده با هـدروژن پـک عبوری و متفاوتی دیده می شود. این عبوری مربوط به پیوند Si با C در عدد موج حدود ۲۰۰۰ می مان طور که انتظار می رود، دیده می شود با این تفاوت که شدت پیک عبوری مربوط به پیوند Si با C در این ناحیه تفاوت چشمگیری با ناحیه بدون هیدروژن دارد.



همچنین چند پیک عبوری دیگر نیز در این ناحیه دیده می شود. دو پیک عبوری مربوط به پیونـد یگانـه C بـا O در عدد موج حدود ¹⁻۱۲۲۰ و پیک عبوری مربوط به پیوند دوگانه C با O در عدد موج حدود ¹⁻۱۷۶۰ کاملاً مشخص است. همچنین پیک عبوری مربوط به پیوند C با H در عدد موج حدود ¹⁻۱۳۶۰ قابل تشخیص است.

نتيجه گيرى

در این مقاله اثر کاشت یون هیدروژن در کیفیت ساختار بلوری SiC ، نحوه توزیع هیدروژن و نحوه پیوند بین اتم های SiC و هیدروژن در دو ناحیه کاشت شده و کاشت نشده با استفاده از تکنیکهای ،-RBS و ERD،AFM Channeling و FTIRبررسی شد. همچنین تاثیر اکسیداسیون گرمایی بلورSiC در محیط اکسیژن در برخی از پارامترهای ذکر شده ، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج AFM نشان داد که کاشت هیدروژن باعث افزایش نایکنواختی سطح بلور و تشکیل حباب های سطحی در سطح بلور می شود که این آسیبها جهت برداشتن لایه های نازکی ازSiC از روی سطح می تواند مفید باشد اما ممکن است در خواص الکتریکی بلور تاثیر منفی داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از RBS-Channeling نشان می دهد که آسیب ایجاد شده در بلور SiC به گونه ای نیست تا شبکه بلوری را به حالت آمورف تبدیل کند که این نتیجه با نتایج حاصل از شبیه سازی RIM همخوانی دارد. با استفاده از ERD توزیع اتم های هیدروژن در SiC با دقت خوبی تعیین شد و مقایسه آن با نت ایج شبیه سازی نشان داد که ماکزیمم توزیع اتم های هیدروژن در عمق حدود ۲۰۰نانومتر هست. این مقایسه همخوانی خوب بین نتایج تجربی و شبیه سازی را نشان می دهد. نتایج آنالیز RBS-Channeling اختلاف بین لایه اکسید رشد داده شده در ناحیه کاشت شده و بدون کاشت را نشان داد. علاوه بر این نتایج حاصل از FTIR نشان داد اگر چه تفاوت چشمگیری بین طیف های بدست آمده از دو ناحیه کاشت شده و کاشت نشده قبل از اکسیداسیون وجود ندارد ، اما شدت پیک عبوری مربوط به پیوند Si با O دو ناحیه کاشت شده و کاشت نشده بعد از اکسیداسیون در این ناحیه تفاوت چشمگیری با هم دارند و پیک مربوط به کربن و هیدروژن در ناحیه کاشت شده به وضوح آشکار می شود.

Refrences:

- 1. Fisher, G.R., and Barnes, P., Phil. Mag., 61, (2), 217 (1990).
- 2. Hayton, D.J., Jenkins, T.E., Bailey, P., and Noakes, T.C.Q., Semiconductor Sci. Tech., 17, 29 (2002).
- 3. Burke, T., Xie, K., Flemish, J.R., Singh, R., Podlesak, T., and Zhao, J. H., *in Proceedings, the Twenty-Second International Power Modulator Symposium.*, **18** (1996).
- 4. Clarke, R.C., and Palmour, J.W., Proc .IEEE., 90, (6), 987 (2002).
- 5. Heliou, R., Brebner, J.L., and Roorda, S., Semiconductor Sci. Tech., 16, 836 (2002).
- Gregory, R., Wetteroth, T.A., Wilson, R.S., Holland, O.W. and Thomas, D.K., J. Appl Phys. Lett., 75, 2623 (1999).
- 7. Radtke , C., Baumvol, I.J.R., and Stedile, F.C., Phys. Rev. B, 66, 155437 (2000).
- 8. Makhtari, A., Raineri, V., LaVia, F., Franz, G., Frisina, F., and Calcagno, L., *Materials Science in Semiconductor Processing.*, **4**, 345 (2001).
- 9. Palmieri, R., Boudinov, H., Radtke, C., and da Silva Jr, E.F., *Appl. Surface Sci.*, **255**, 706 (2008).
- 10. Nipoti, R., Madrigali, M., and Sambo, A., Mat. Sci. Engin. B, 61-62, 475 (1999).
- 11.Biersack,P., and Ziegler,J.F., *The stopping and range of ions in solids*, Pergamon Press, New York (1985).
- 12. Baghizadeh, A., Agha-Aligol, D., Talebi- Taher, A., and Lamehi-Rachti, M., Iranian Phys. J., 1, 38 (2007).
- 13. Mayer, M., SIMNRA User's Guide, Report IPP 9/113, Max-Planck-Institut für plasmaphysik, Garching, Germany (1997).
- 14. Dogan, S., Johnstone, D., Yun, F., Sabuktagin, S., and Leach, J., *J. Appl Phys. Lett.*, **85**, 154 (2004).
- 15. Vickridge, I., Ganem, J., Hoshino, Y., and Trimaille, I, J. Phys .D: Appl. Phys., 40, 6254 (2007)
- 16.Hashimoto, H., Hijikata, Y., Yaguchi, H., and Yoshida, S., *Appl. Sur. Sci.*, **255**, 8648 (2009).
- 17. Hossain, K., Holland, O.W., Naab, F.U., Mitchell, L.J., Poudel, P.R., Duggan, J.L., and McDaniel, F.D., *J. Phys. Res.* B, **261**, 620 (2007).
- 18. Afanas, V.V., Ciobanu, F., Dimitrijev, S., Pensl, G, and Stesmans, A., J. Phys. Condens. Matter., 16, 1839 (2004).
- 19. Huisken, F., Kohn, B., Alexandrescu, R., Cojocaru, S., Crunteanu, A., Ledoux , G., and Reynaud , C., J. Nanoparticles Res., 1 (2), 293 (1999).